

「電子材料関連技術の最近の進展」特集

Recent Development on Electronics Materials and Related Technologies

半導体および関連材料、微細加工技術、実装技術、検査技術など、電子材料関連技術の重要性はIoT時代になってますます重要化しています。さらに、光技術との融合、印刷による回路など、関連技術の発展により、これまで考えられなかったデバイス形態が実現しています。電子材料に関連する様々な技術の進展に関して、最新の情報を取り入れることは有意義であると考え、論文誌C（電子・情報・システム部門誌）2021年7月号にて「電子材料関連技術の最近の進展」特集号を企画します。

高耐圧、高温対応の化合物半導体、酸化物半導体、スピントロニクス材料、有機半導体、ナノ材料、さらには基板材料・コネクタ材料・導電性インクなど、新しい形態のデバイスに向けて、様々な材料が開発されています。また、材料の微細形状を制御して機能をもたらすプロセス技術も新材料それぞれに必要となり、関連する人材育成も重要です。我が国は材料技術に強みを持つといわれていますが、諸外国の動向を踏まえると産官学のそれぞれで問題点が浮き彫りになりつつあります。このような状況に鑑み、本特集号では先端的研究の報告をはじめとして、学術的サーベイ、応用・実証例等の実用性・有用性に富む報告も歓迎します。

以下にキーワードを挙げますが、必ずしもこれにとらわれることなく、関連する周辺分野からの奮ってのご投稿をお待ちしています。なお、査読の都合により特集号に掲載できない論文は、一般論文として取り扱われますので、あらかじめご了承ください。

キーワード：半導体、磁性体、基板材料、実装関連材料、スピントロニクス、プロセス技術
投稿締切：2020年9月28日（月）

詳細は電気学会の論文投稿手続きに従って下さい。

http://www.iee.jp/?page_id=642 から原稿作成の手引きをダウンロードできます。

投稿方法：投稿は電子投稿・査読システムで受け付けます。

<https://submit.iee.or.jp/main/cgi/sstk-top.cgi> からご投稿下さい。

電子投稿・査読システムの「論文・資料・研究開発レターの投稿」画面において

「論文誌C」を選択し、次に原稿種別（論文／資料／研究開発レターのどれか）を選択した後、「原稿投稿」画面において「電子材料関連技術の最近の進展」特集を選択して下さい。電子メールを用いた投稿、郵送での投稿は受け付けられませんのでご注意ください。

ゲストエディタ／問合せ先：島田 敏宏 北海道大学

〒060-8628 北海道札幌市北区北13条西8丁目 E-mail: shimadat@eng.hokudai.ac.jp

※()⇒メール送信時に、()を@に変えて送信ください。

企画協力：電子材料技術委員会